

证券代码:300223

证券简称:北京君正

公告编号:2025-030

北京君正集成电路股份有限公司 关于对部分全资子公司进行增资和减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）第六届董事会第四次会议通过了《关于向全资子公司芯成半导体（上海）有限公司增资并对合肥君正科技有限公司减资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

根据公司总体规划，经公司第六届董事会第二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，公司将“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”，募集资金项目承担主体由全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）变更为芯成半导体（上海）有限公司（以下简称“上海芯成”）。公司将对原承担“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的全资子公司合肥君正科技有限公司进行减资，“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”结余的募集资金加现金管理收益及利息扣除银行手续费净额 23,560.28 万元将由公司通过全资子公司北京矽成半导体有限公司向承担“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”的芯成半导体（上海）有限公司进行增资。上述子公司将相应办理相关增资和减资事项的工商变更手续。

二、本次增资主体基本情况

1、公司名称：芯成半导体（上海）有限公司

统一社会信用代码：913100006074199240

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 25 号 1 楼

法定代表人：韩光宇（KONG-YEU HAN）

注册资本：28851.0258 万元

成立日期：2000-09-15

经营范围：一般项目：设计、委托加工超大规模集成电路半导体产品和应用系统及制作相关软件，销售自产产品，提供相关技术服务，以及为本公司及其投资者所拥有、控制或关联企业提供经营决策和管理咨询服务、财务管理服务、提供产品采购的质量控制和管理服务、信息服务及员工管理服务以及相关商务咨询服务、在中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 25 号 2-5 楼内从事自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、公司名称：北京矽成半导体有限公司

统一社会信用代码：91110302318129402G

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 3 层 301-1

法定代表人：刘强

注册资本：54319.505003 万元

成立日期：2014-11-02

经营范围：设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（该企业 2020 年 4 月 1 日前为外资企业，于 2020 年 4 月 1 日变更为内资企业；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次减资主体基本情况

公司名称：合肥君正科技有限公司

统一社会信用代码：91340100092860293D

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市高新区大龙山路 1855 号君正科技园 C 座一层 101

法定代表人：张紧

注册资本：25280 万元

成立日期：2014-02-14

经营范围：半导体集成电路芯片的研发、设计、委托加工、销售；计算机软、

硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备的设计、开发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、审议程序及相关意见

公司于2025年5月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司芯成半导体（上海）有限公司增资并对合肥君正科技有限公司减资的议案》，同意上述子公司增资及减资事项。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日